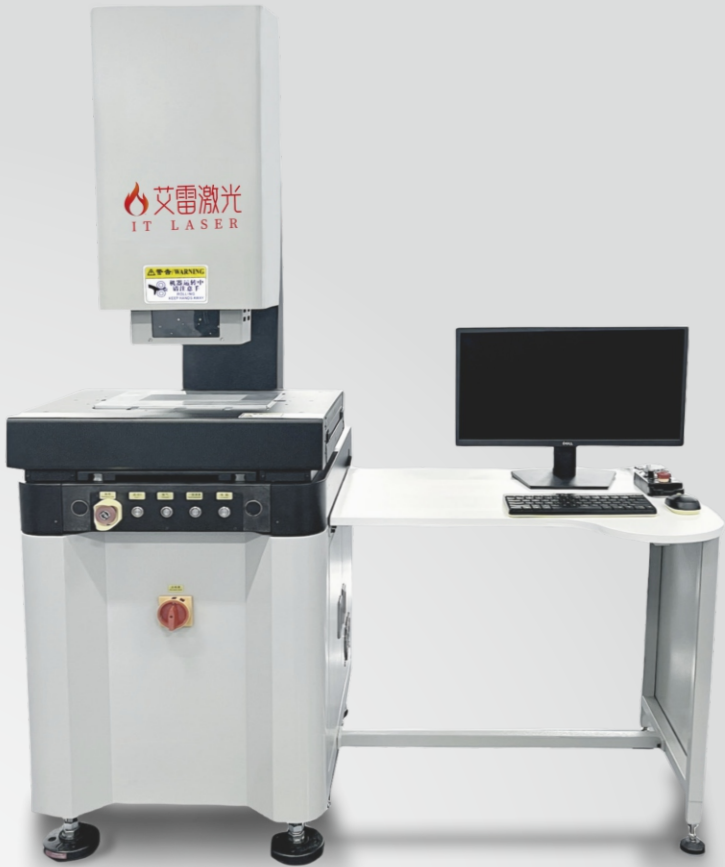


2.5D复合影像测量仪

2.5D COMPOSITE IMAGE MEASURING INSTRUMENT



复合测量

1D/2D/2.5D复合测量

高精度运动平台

采用大理石基座、精密线性导轨、玻璃工作台

强大图像算法

拥有多种精细图像算法能力

产品概述 / Product Overview

2.5D复合影像测量仪 采用大理石基座、精密线性导轨、玻璃工作台，确保高精度、高稳定性、高性价比。可根据实际测量需求，在光学传感器的基础上搭配激光位移传感器、光谱共焦位移传感器、接触式位移传感器、探针等，结合功能强大的复合测量软件，完成2D平面尺寸、3D轮廓的复合测量，满足多行业检测应用所需。

应用领域 / Application Fields

2.5D复合影像测量仪广泛适用于3C电子、电池、PCB板、五金、医疗器械、汽车零部件、航空航天等领域。

产品优势 / Product Advantages

- 多传感器复合系统
可实现平面尺寸、段差、平面度、厚度、轮廓尺寸等多种测量需求；
- 功能强大的复合测量软件
具有2D/3D测量、形位公差评价、脱机编程等功能；
- 强大的图像算法
拥有高精度图像拼接、弱边测量、强化边缘、自动寻边、毛刺过滤等算法能力；
- 丰富的SPC统计分析工具
可自动生成均值和极差图、正态分布图、及Cpk、GRR等报告。

技术参数 / Technical Specifications

设备型号	IT-LC-2.5DCL3020E/A/P/C	IT-LC-2.5DCL4030E/A/P/C
测量行程	300X200X200mm	300X200X200mm
外形尺寸	600X800X1680mm	700X900X1680mm
整体重量	460kg	580kg
工作台承重	25kg	25kg
光栅尺分辨率	0.1μm/0.5μm	
XY轴测量精度	E2=(2.5+L/200)μm	
Z轴测量精度	E1=(5+L/200)μm	
图像传感器	高分辨率工业像机(彩色/黑白)	
镜头	6.5X自动变倍镜头	
照明	分环分区表面光+同轴光+底部平行光	
光谱共焦位移传感器(选配)	光点直径φ3.5μm~φ75μm, 直线性±0.2μm~±4.6μm	
激光位移传感器(选配)	光点直径φ25μm~φ120μm, 重复精度0.02μm~0.25μm	
接触式位移传感器(选配)	分辨率0.1μm/0.5μm, 精度1μm~3.5μm	
探针(选配)	红宝石直测针/星型测针, 球径φ0.3mm~φ4.0mm	
工作电源	220V±10%, 单相, 50/60Hz, 接地电阻<4Ω	
环境温度	18℃~22℃	
环境湿度	30%~80%	
振动强度	振动<0.002g, 低于15Hz	